

目次

中文摘要	i
英文摘要	ii
誌謝	iv
目錄	v
表目錄	viii
圖目錄	xi
第一章 緒論	1
1.1 前言	1
1.2 研究背景與動機	3
1.3 文獻回顧	4
1.4 論文架構	6
第二章 色彩模型探討	8
2.1 RGB 色彩模型	9
2.2 CMY&CMYK 色彩模型	11
2.3 YIQ 色彩模型	12
2.4 HSI 色彩模型	13
2.4.1 由 RGB 轉換至 HSI 色彩模型	15
2.4.2 由 HSI 轉換至 RGB 色彩模型	19
2.5 HSV&HSB 色彩模型	22
2.6 HLS 色彩模型	24
第三章 基本影像處理	27
3.1 二值化	28
3.2 邊緣偵測	30
3.3 細線化	32
3.4 連通成分的標示	35
3.5 雙線性內插法	38
3.6 影像投影	41
第四章 研究方法與步驟	43
4.1 擷取影像	45
4.2 電路板自動定位	47
4.3 找出待測元件的位置	53
4.4 特徵辨識	57
4.4.1 平均值與變異值	57
4.4.2 不變矩	58
4.4.3 歐幾里德距離	60

第五章 實驗結果-----	62
5.1 實驗安排-----	62
5.2 檢測元件缺陷的方法-----	64
5.3 辨識結果-----	69
第六章 結論-----	89
參考文獻 -----	91
個人資料 -----	94